

エレクトロニクス実装学会 関西支部主催
協賛：表面技術協会関西支部、溶接学会（予定）

第7回技術講演会『先端実装材料技術の最新動向』のご案内

この度、エレクトロニクス実装学会関西支部では、「先端実装材料技術の最新動向」と題するテーマで技術講演会を開催する運びとなりました。製品の高性能化、ローコスト化には、実装技術が重要な役割を占めており、それを支えるのは材料技術と言っても過言ではありません。本講演会では、各種実装分野の最新のハイテク材料技術について、講師方々に専門的な立場でご講演頂き、みなさんで徹底的に議論して頂きます。多くの方々のご参加をお待ちしております。

期 日：2011年 2月18日（金）13:00 ～ 16:50

会 場：[大阪大学 中之島センター](#) 7階 講義室2

プログラム：12:30 - 13:00 講演会受付

13:00 - 13:05 開会挨拶

・講演 1, 2

座長 シャープ(株) 頼 明照 氏

13:05 - 13:55

『焼結型マイクロAg粒子ペーストを用いた高信頼ダイボンディング技術の開発』

(株)日立製作所 梶原 良一 氏

環境規制によりダイボンド材の鉛フリー化要求が強い。本講演では、マイクロAg粒子を溶剤でペースト化した材料の無加圧接合性と接合組織、焼結Ag接合部の補強方法、焼結Agでダイボンドしたパッケージの熱・電気特性や温度サイクル信頼性について紹介する。

13:55 - 14:45

『Cu pillar 対応UFの開発』

ナガセケムテックス(株) 野村 和宏氏

高集積化が進む中でアンダーフィル剤に求められる特性は多様化している。その中で特にLow-kチップを使用した鉛フリー半田バンプ、Cu pillarに対応できる先置き後入れそれぞれのアンダーフィル材料について必要な物性について検討した結果を紹介する。

14:45-15:00

休 憩

・講演 3, 4

座長 大阪大学 田畑 晴夫 氏

15:00 - 15:50

『低誘電正接・低CTE・微細粗面ビルドアップ絶縁材料』

積水化学工業(株) 伏見 勝夫氏

半導体パッケージ用ビルドアップ基板の層間絶縁材料には、微細粗面化、低熱線膨張率(CTE)化、低誘電正接化が求められている。積水化学では、セミアディティブ工法に適用できるエポキシ系樹脂で、これらの要求に応えるべく開発を行ってきた結果、高いレベルでバランスをとることができたので紹介する。

15:50 - 16:40

『メソゲンを含有する高熱伝導エポキシ樹脂コンポジットシート』

日立化成工業(株) 西山 智雄氏(竹澤由高氏)

液晶構造などの秩序性の高い高次構造を樹脂内部に形成したメソゲン含有エポキシ樹脂に無機フィラーを配合することで、熱伝導性と絶縁性を両立したコンポジットシートを設計、開発した。その樹脂技術と材料設計について講演する。

16:40 - 16:50

閉会挨拶

主 催：(社)エレクトロニクス実装学会 関西支部

事務局：大阪大学大学院工学研究科 上西研究室 06-6879-4078(陶山・上西)

参加要領：* 定 員 85名(先着申込順)

* 参加費 (入金確認後、参加証を送付させていただきますのでご確認下さい。)

正会員・賛助会員：8,000円(大学・公立・独行・NPO研究機関の方は6,000円)

非会員：13,000円 / 学 生：3,000円

* 賛助会員は1口1名の参加枠となります。

* 申し込みと同時に入会されますと、会員料金となります。

申込用紙 JIEP関西支部 第7回技術講演会に参加申し込み致します

* 宛先

E-mail : kansai@jiep.or.jp FAX :06-6879-4598

* 会員区分(該当内容に○印を付けて下さい)

() 正会員(会員番号) / () 賛助会員
() 大学・公立・独行・NPO研究機関(正・賛助)会員(会員番号)
() 非会員 / () 学 生

* 氏 名

* 氏名ふりがな

* 所属団体名

* 所属部署名

* 郵便番号

住 所

TEL.

FAX.

E-mail

* 請求書(該当内容に○印を付けて下さい)

() 要 () 不要

会員区分にご記入がない場合は、非会員として受付処理をさせていただきますので、会員の方は、必ずご記入ください。